

2023年11月14日

各位

会社名：ウインテスト株式会社
(コード：6721 東証スタンダード市場)
代表者名：代表取締役社長 姜 輝
問合せ先：専務取締役 樋口 真康
(TEL：045-317-7888)

業績予想の修正に関するお知らせ

当社は、最近の業績動向を踏まえ、2023年2月14日に公表いたしました2023年12月期累計期間(2023年1月1日～2023年12月31日)の業績予想につきまして、下記の通りお知らせいたします。

記

(1) 2023年12月期連結業績予想数値の修正(2023年1月1日～2023年12月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社に帰属 する当期純利益	1株当たり 当期純利益
前回予想(A)	百万円 1,300	百万円 50	百万円 50	百万円 50	円 銭 1.38
今回修正予想(B)	522	△465	△435	△468	△10.72
増減額(B - A)	△777	△515	△485	△518	
増減率(%)	△59.8	-	-	-	
前期実績(参考)	210	△693	△683	△686	△19.87

(2) 修正の理由

当第3四半期連結累計期間における半導体市場は、新型コロナウイルス禍に伴う、急激なテレワーク需要によるPC、スマホ等のIT機器向け半導体の急激な需要増の反動を受け、アフターコロナ後は、急激に民生向け半導体需要が減ったことで、半導体市場は、過剰在庫状態になり、各製造工場は、新規投資を見合わせる状況となりました。当初、JEITA半導体部会等によると半導体の生産調整は、2023年上半期には終息するとの予測を立てておりましたが、当第3四半期末現在においては、各社の製造数量に増加は見えるものの、引き続き半導体各社の新規設備投資に積極的な動きは見られず、慎重な姿勢を崩していない状況です。

当第3四半期連結累計期間においては、上述のように、お客様工場の生産調整による新規設備投資抑制が色濃く残り、長期化したことから、当社が期待していた受注未達に終わることとなり、業績は、低迷いたしました。また、当初の想定以上に半導体部材の原価が高騰し、次世代半導体検査装置の開発費用が増加したことにより、利益面において業績を圧迫している状況にあります。このため、2023年2月14日に開示した、当初の通期業績予想は、達成困難となりましたので、2023年12月期累計期間の業績予想を上記の通り変更することといたしました。

(注) 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した予想であり、リスクや不確実性を含んでおります。従いまして、実際の業績等は、今後様々な要因によって異なる可能性があります。

以上